PRIORITY OCUMENT ITTED OR TRANSMITTED IN ANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



PCT/ IB 04/02543

MAILED: 18 AUG 2004

WIPO PCT

Ministero delle Attività. Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

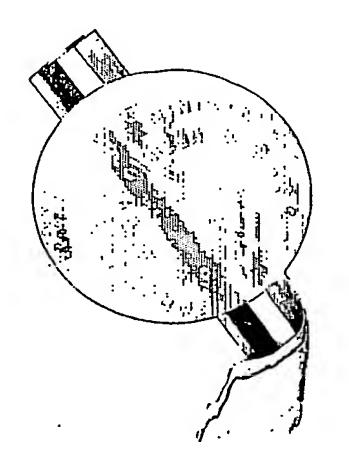
Ufficio G2

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: INVENZIONE INDUSTRIALE N. TO 2003 A 000605 del 05.08. 2003

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

≥4 A 60. 2004

Roma, li.



IL FUNZIONARIO

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALEN. 2003 A 000 605

A. RICHIEDENTE/I													****	D- 17 G	AGO, IIII
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1	C.R.F. S	SOCIET!	L CONSC	ORTILE I	PER AZION	NI				W.	MIS	TER	<u> </u>	AGRICOUN
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	176		FISCALE TA IVA	1 4 3	0708456	60015			·					80110
INDIRIZZO COMPLETO	A4)RBASSAN	ATI) OT ON	ALIA)							
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1							——————————————————————————————————————			IRE 100	i ma	でである。	0 100	
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	1 1		FISCALE TA IVA	1 4					IXIXI	100	掌		ATION	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			<u> </u>			•				ADABOLEO	陸			
A. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	В0		(D = D)OMICIL	JO ELET	TIVO, R=	· Rappres	SENTANTE)			000	10,	Michael Control of the Control of th	次 個	N. P. Walley
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1										~~	स्त ।	4F		
INDIRIZZO	B2							•							
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	В3														
C. TITOLO	CI	DISPOSIT	rivo"					IVI DI RILEVA						ATIVO	
D. INVENTORE/I DESIGNAT	I/O'I	(DA INC	DICAR	E ANC	HE SE	L'INVE	TORE C	COINCIDI	E COI	N IL RI	CHIEDE	ENTE)	<u>,</u>	,	
COGNOME E NOME	D1	PULLINI	DANIE	ile				•							
Nazionalità	D2	ITALIAN	IA .										-	 ,	
COGNOME E NOME	D1	MARTOR	rana B	RUNETI	10			•							
Nazionalità	D2	ITALIAN	Į A												
COGNOME E NOME	D1	PERLO P	'IERO												
Nazionalità	D2 .	ITALIAN	iA	<u> </u>							•				
COGNOME E NOME	D1												<u> </u>		
Nazionalità	D2						<u> </u>					<u></u>			
•	Sez	ZIONE	•	Cı	ASSE		SOTT	OCLASSE		G	SRUPPO			SOTT	OGRUPPO
E. CLASSE PROPOSTA	E1			E2			E3			E4				E5	
F. PRIORITA'		DERIVAN	TE DA PR	LECEDEN	TE DEPO!	SITO ESEGI	JITO ALL'EST	TERO							
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1			27 - 27							Tipo	F2			
NUMERO DI DOMANDA	F3								 1	Data I	DEPOSITO	F4	- 		 ;
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1	<u> </u>		·					+		TIPO	F2			
NUMERO DI DOMANDA	F3							,	$\dashv_{\mathfrak{r}}$	Data E	DEPOSITO	F4			
G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI	G1			1											
FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I		g. Gland N. lacq lin prope	ge.Ayo	258	ARO B Bliris										•

MODULO A (2/2)

IANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'UIBM

E SOTTOINDICATA/E PERSONA/E HA/I LANO BREVETTI E MARCHI CON L'INCA	HANN	O ASSUNTO IL MANDATO A RAPPRESENTARE IL TITOLARE DELLA PRESENTE DOMANDA INNANZI ALL'UFFICIO DI EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI AD ESSA CONNESSI (DPR 20.10.1998 N. 403).								
		N. ISCR. ALBO 258 NOTARO GIANCARLO; N. ISCR. ALBO 259 BUZZI FRANCO;								
IMERO ISCRIZIONE ALBO GNOME E NOME;	~~	N. ISCR. ALBO 260 BOSOTTI LUCIANO; N. ISCR. ALBO 507 MARCHITELLI MAURO;								
		N. ISCR. ALBO 335 SERTOLI GIOVANNI								
:NOMINAZIONE STUDIO	I2									
DIRIZZO	I 3	VIA MARIA VITTORIA, 18								
\P/Località/Provincia	I4	10123 TORINO - TO								
ANNOTAZIONI SPECIALI	L1	•								
		•								
DOCUMENTAZIONE ALI	LEGA	TA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE								
TIPO DOCUMENTO		NES ALL N. ES. RIS. N. PAG. PER ESEMPLARE								
OSPETTO A, DESCRIZ., RIVENDICAZ.	Ţ	2 17								
BBLIGATORI 2 ESEMPLARI) SEGNI (OBBLIGATORI SE CITATI IN		$\frac{1}{2}$								
SCRIZIONE, 2 ESEMPLARI)	<u> </u>									
SIGNAZIONE D'INVENTORE										
OCUMENTI DI PRIORITÀ CON ADUZIONE IN ITALIANO		· ·								
UTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE										
	-	(SI/NO)								
TTERA D'INCARICO	-	si ·								
ROCURA GENERALE		NO								
FERIMENTO A PROCURA GENERALE		NO								
•	(1	IMPORTO VERSATO ESPRESSO IN LETTERE								
TTESTATI DI VERSAMENTO		€ CENTOTTANTOTTO/51 (€ 188,51)								
OGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI	F	DF								
ARAGRAFI (BARRARAE I PRESCELTI) EL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA		Sì								
UTENTICA? (SI/NO) CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ	.	NO								
L PUBBLICO? (SI/NO)	- 									
'ATA DI COMPILAZIONE		07/08/2003								
IRMA DEL/DEI	ing.	Giancarlo NOTARO N. Iscriz, ALBO 268/								
ICHIEDENTE/I	Į le	proprio e per gl aliri)								
	, , ,	VERBALE DI DEPOSITO								
NUMERO DI DOMANDA		2003 A 0 0 0 6 0 5								
C.C.I.A.A. D	<u> </u>	ORINO COD. 01								
IN DATA		/08/2003 , IL/I RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME								
LA PRESENTE DOMANDA C	ORREI	PATA DI N. FOGLI AGGIUNTIVI PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO SOPRARIPORTATO.								
J. ANNOTAZIONI VARIE										
DELL'UFFICIALE ROGANTE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
IL DEPOSITANTE	<u>_</u>	/ L'UFFICIALE ROGANTE								
CTS UP Put		CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRISEARII GIAPINTO E AGRICOLTURA CATEGORIA C CATEGORIA C								

PROSPETTO MODULO A DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

A. RICHIEDENTE/I COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE, RESIDENZA O STATO
C.R.F. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
ORBASSANO TO

C. TITOLO
"PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DI CAMPI MAGNETICI E RELATIVO DISPOSITIVO"

NISTE

NISTE

SEZIONE

CLASSE

SOTTOCLASSE

GRUPPO
SOTTOGRUPPO

E. CLASSE PROPOSTA

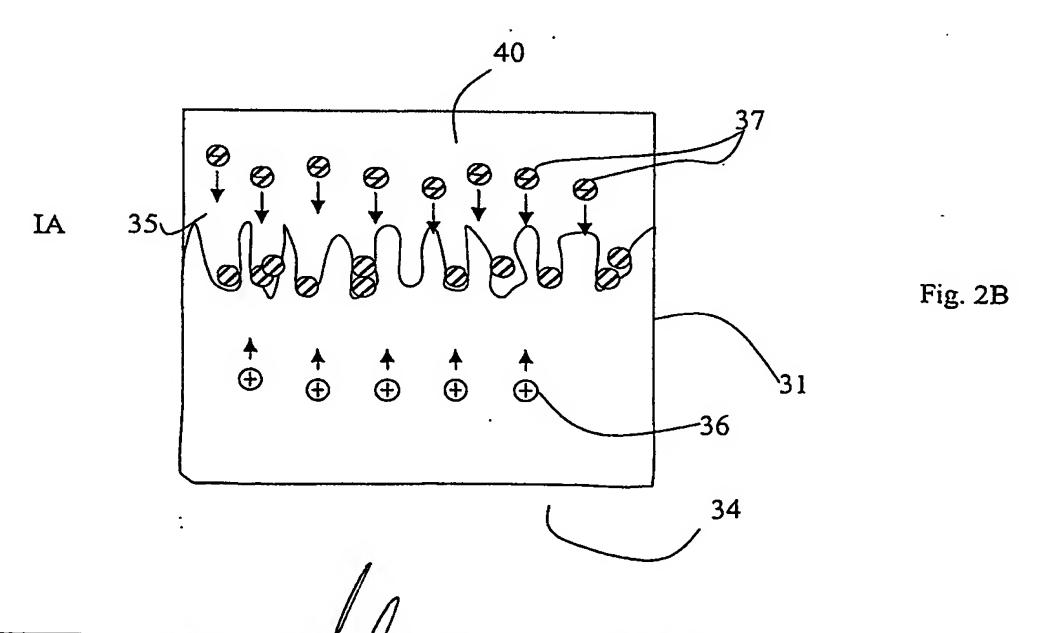
O. RIASSUNTO

PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DI CAMPI MAGNETICI, DETTO PROCEDIMENTO COMPRENDENDO LE OPERAZIONI DI FABBRICARE UN ELEMENTO MAGNETORESISTIVO (10; 20) COMPRENDENTE REGIONI A CONDUZIONE METALLICA (13; 23) E REGIONI A CONDUZIONE SEMICONDUTTIVA (11; 31). DETTO PROCEDIMENTO COMPRENDE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- FORMARE DELLE NANOPARTICELLE METALLICHE (37) PER REALIZZARE DETTE REGIONI A CONDUZIONE METALLICA (13; 23);
- PROVVEDERE UN SOTTOSTRATO DI SEMICONDUTTORE (31);
- APPLICARE DETTE NANOPARTICELLE METALLICHE (37) A DETTO SOTTOSTRATO DI SEMICONDUTTORE (31) PER OTTENERE UNA STRUTTURA MESOSCOPICA DISORDINATA.

(FIGURA 2B)

P. DISEGNO PRINCIPALE



FIRMA DEL/DEI

RICHIEDENTE/I

Ing. Glancerio, MOTARO N. isoriz/ALIO/758

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO di: C.R.F. Società Consortile per Azioni, nazionalità italiana, Strada Torino 50, 10043
Orbassano TO

Inventori designati: PULLINI Daniele; MARTORANA
Brunetto; PERLO Piero

Depositata il: 05 Agosto 2003 TO 2003 A 000605

TESTO DELLA DESCRIZIONE

La presente invenzione riguarda un procedimento di fabbricazione di un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, detto procedimento comprendendo le operazioni di fabbricare un elemento magnetoresistivo comprendente regioni a conduzione metallica e regioni a conduzione semiconduttiva.

E' noto nello stato dell'arte impiegare, al fine di rilevare campi magnetici, dei sensori magnetoresistivi, ovverosia dispositivi la cui resistenza al passaggio della corrente elettrica varia al variare del campo magnetico a cui vengono sottoposti. In particolare, sono noti sensori magnetici detti AMR (Anisotropic Magneto

Resistance), usualmente realizzati attraverso un film sottile di ferro-nichel (permalloy), depositato su un wafer di silicio e sagomato in forma di striscia resistiva.

L'applicazione di un campo magnetico esterno variazione dell'orientamento della determina una magnetizzazione nel permalloy, rendendo la sua magnetizzazione non parallela alla corrente fluisce nella striscia resistiva e aumentando quindi la resistenza. Detti sensori AMR cambiano la propria resistenza del 2-3% in presenza di campi magnetici. poter apprezzare efficacemente di la fine Al variazione di resistenza, i sensori AMR vengono quindi depositati in modo da formare un ponte di Wheatstone.

La variazione di resistenza è pero legata all'instaurarsi dell'effetto magnetoresistivo, presente in una limitata quantità di materiali analoghi al permalloy.

Inoltre tali sensori non sono facilmente integrabili e miniaturizzabili. Dal brevetto statunitense No. U.S. 6,353,317 è noto impiegare una struttura di semiconduttore poroso per creare dei nanofili o nanotubi, che vengono successivamente riempiti di materiale magnetico. In figura 1 è

illustrato un elemento magnetoresistivo 10, facente parte di un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, indicato nel suo complesso tramite il riferimento 15, ottenuto tramite deposizione metallo nei pori di un semiconduttore poroso. Tale magnetoresistivo .10 comprende elemento un sottostrato di semiconduttore 11, nel quale sono presenti dei pori 12. All'interno dei pori 12 sono presenti dei cilindri 13 di materiale metallico. Al sottostrato di semiconduttore 11 sono applicati 14. laterali Il sottostrato di elettrodi semiconduttore 11 è costituito da un semiconduttore ad altà mobilità, ad esempio InAs. Il funzionamento del dispositivo 15 è il seguente.

Agli elettrodi laterali 14 viene applicata una tensione V atta a determinare una corrente I, che fluisce fra gli elettrodi 14 ed il cui valore è determinato dalla resistenza dell'elemento magnetoresistivo 10. Detta resistenza è sostanzialmente dovuta ai flussi di corrente attraverso i cilindri 13 metallici, che hanno resistenza più bassa.

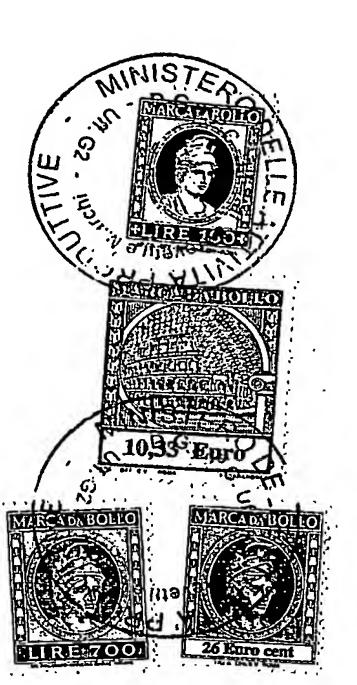
In presenza di un campo magnetico esterno H, nei cilindri 13 si realizza, a cagione della forza di Lorentz, una distribuzione di carica spaziale che

determina un campo elettrico tendente a escludere il passaggio di corrente al loro interno. Pertanto il valore della corrente I che fluisce nell'elemento magnetoresistivo 10 è determinato dalla resistenza del sottostrato di semiconduttore 11, che è più elevata. Inoltre, in esso i cammini elettronici sono ciò contribuisce tortuosi e lunghi piu' di resistenza nell'elemento all'aumento magnetoresistivo 10. Dunque il dispositivo di 15 permette di rilevare un campo rilevamento magnetico H tramite la brusca variazione, in particolare il brusco aumento in presenza del campo della resistenza dell'elemento H, magnetico magnetoresistivo 10.

Il materiale semiconduttore poroso che costituisce il sottostrato 11 è prodotto tramite una tecnica di reactive ion etching applicata a un wafer di semiconduttore, mentre il metallo che costituisce i ci'lindri 13 nei pori 12 viene depositato a mezzo di un procedimento di deposizione elettrochimica.

Un simile procedimento tuttavia è abbastanza complesso e costoso, coinvolgendo un processo di reactive ion etching per la creazione di isole conduttive nel semiconduttore.

La presente invenzione si prefigge lo scopo di



realizzare una soluzione in grado di fabbricare un dispositivo di rilevazione di campi magnetici comprendente regioni a conduzione metallica e regioni a conduzione semiconduttiva in maniera semplice e economica.

Secondo la presente invenzione, tale scopo viene raggiunto grazie ad un procedimento avente le caratteristiche richiamate in modo specifico nelle rivendicazioni che seguono.

L'invenzione verrà descritta con riferimento ai disegni annessi, forniti a puro titolo di esempio non limitativo, in cui:

- la figura 1 rappresenta uno schema di principio di un dispositivo di rilevamento di campi magnetici;
- le figure 2A, 2B e 2C rappresentano dei passi di un procedimento di fabbricazione di un dispositivo di rilevamento di campi magnetici secondo l'invenzione.

L'idea alla base del procedimento secondo l'invenzione è di realizzare l'elemento magnetoresistivo del dispositivo di rilevazione di campi magnetici tramite una struttura mesoscopica disordinata di nano particelle metalliche in un sottostrato semiconduttore a alta mobilità e band

gap stretto.

E' proposto, con riferimeno alle figure 2A, 2B e 2C perciò un procedimento di fabbricazione di un elemento magnetoresistivo 20 analogo per scopi e funzionamento all'elemento magnetoresistivo mostrato in figura 1. Tale procedimento in un primo passo prevede di preparare delle nanoparticelle o cluster di materiale metallico, tramite un processo di sintesi di colloidi metallici o altro processo noto di sintesi di nanoparticelle metalliche. Tali particelle nanometalliche, indicate il con riferimento 37 in figura 2B, alternativamente, sono anche disponibili in commercio e possono essere semplicemente acquistate.

In un secondo passo del procedimento di fabbricazione proposto tali nanoparticelle metalliche vengono inserite unite ad un opportuno solvente in una soluzione 40. Il solvente può essere a titolo d'esempio glicole o acetone.

Un terzo passo del procedimento proposto prevede di rendere poroso un sottostrato di materiale semiconduttore 31. In una versione preferita, un template 38 di allumina anodizzata è applicato in funzione di maschera sulla superficie del sottostrato semiconduttore 31. Detto template di

allumina anodizzata 38 è provvisto, in virtù del processo di anodizzazione a cui è stato sottoposto, di pori nanometrici 39, sicchè è possibile eseguire successivamente degli attacchi acidi o etching spazialmente selettivi, in particolare tramite un attacco acido di tipo elettrochimico, attraverso i pori 39 del template 38 di allumina anodizzata.

In particolare, una corrente IA viene fatta passare attraverso una soluzione elettrolitica 32 acida tra detto sottostrato di semiconduttore 31, 34 provvisto di contatto posteriore che un costituisce l'anodo, e un filamento di platino 33, che costituisce il catodo. Nella soluzione il trasporto di carica può avvenire solamente se all'interfaccia elettrolita/semiconduttore si ha un passaggio di carica tra uno ione della soluzione elettrolitica 32, indicato con il riferimento 35 in figura 2A, e ioni 36 positivi del sottostrato 31 di silicio. Ciò avviene mediante una reazione chimica l'anodo, nel caso specifico dissolve che sottostrato 31 di semiconduttore. In conseguenza di ciò dei pori 22 si sviluppano in profondità nel sottostrato 31 dissolvendolo parzialmente.

In una versione preferita del procedimento tale attacco acido viene eseguito fino a ottenere dei

pori 22 passanti attraverso l'intero volume del sottostrato 31 di semiconduttore.

E' possibile impiegare anche altre maschere nanoporose in luogo dell'allumina, quali polimetilacrilato (PMMA) o polimidi.

Un quarto passo del procedimento, illustrato in prevede quindi di applicare tale 2B, figura soluzione 40 contenente nanoparticelle metalliche 37 semiconduttore 31, ora reso di sottostrato al poroso, tramite un processo di precipitazione o nanoparticelle Le condensazione capillare. metalliche 37 penetrano per capillarità, all'interno la mentre matrice nanoporosa, della pori dei liquida della soluzione evapora, dando frazione luogo a un fenomeno di condensazione capillare.

Alternativamente, in luogo della precipitazione capillare, in luogo della precipitazione o condensazione capillare è possibile impiegare un metodo di deposizione elettrochimica per depositare le nanoparticelle metalliche 37 nei pori 22.

In un quinto passo viene poi eseguito un processo di annealing termico al fine di fondere o aggregare dette nanoparticelle metalliche in una struttura colonnare o nanorod 23, mostrato in figura 2C, e abbassarne la resistenza, ottenendo un



elemento magnetoresistivo 20 costituito da una matrice porosa di semiconduttore con pori 22 riempiti di materiale metallico.

Secondo un ulteriore aspetto inventivo del procedimento proposto, la sostituzione della soluzione elettrolitica 32 nel terzo passo con la soluzione 40 contenente le nanoparticelle metalliche 37 avviene progressivamente senza scoprire la superficie del sottostrato 31, lasciando cioè uno strato di elettrolita 32 sufficiente a coprire i pori 22, e a impedire quindi che l'aria o il gas ambiente vi penetri. Ciò renderebbe difficile la penetrazione in profondità delle nanoparticelle metalliche 37.

Successivamente, in un passo non mostrato nelle figure, quindi, l'elemento magnetoresistivo 20 viene provvisto di contatti laterali, analoghi a quelli mostrati in figura 1, tramite un processo di evaporazione metallica.

Le nanoparticelle metalliche possono essere di un qualsiasi metallo come oro, argento, alluminio, gallio, indio, rame, cromo, stagno, nichel, ferro, platino, palladio, cobalto, tungsteno, molibdeno, tantalio, titanio, permalloy, così come altre leghe ferromagnetiche o altre leghe con conduzione di tipo sostanzialmente metallico.

Il sottostrato di semiconduttore 31 può essere deposto su un altro substrato isolante qualsiasi e.g. silicio o vetro mediante i procedimenti più differenti quali elettrodeposizione continua o impulsata, metodi elettrochimici, precipitazione semplice, centrifugazione, evaporazione termica o electron beam, sputtering semplice o magnetron, CVD, PECVD, serigrafia.

La soluzione appena descritta consente di conseguire notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni note.

E' proposto un procedimento di fabbricazione di un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, magnetoresistivo elemento equipaggiato un con comprendente regioni a conduzione metallica (13; 23) a conduzione semiconduttiva, regioni e vantaggiosamente prevede di adottare una struttura mesoscopica disordinata, con preparazione separata successiva metalliche nanoparticelle e di applicazione ad un sottostrato di semiconduttore con processi semplici ed economici.

Naturalmente, fermo restando il principio del trovato, i particolari di costruzione e le forme di attuazione potranno ampiamente variare rispetto a quanto descritto ed illustrato a puro titolo di esempio, senza per questo uscire dall'ambito della presente invenzione.

In una possibile variante al procedimento di fabbricazione proposto, si può prevedere, al fine di realizzare un elemento magnetoresistivo con una struttura mesoscopica disordinata comprendente aree aree metalliche aventi diverse semiconduttive e seconda del conduzione a proprietà di magnetico applicato, in virtù del costituirsi di una zona di carica spaziale nelle aree metalliche a cagione della forza di Lorentz, di coevaporare dette nanoparticelle metalliche nell'ambito di un processo di crescita di un sottostrato di semiconduttore. Ad esempio, è possibile coevaporare delle particelle di di crescita di un processo il durante oro sottostrato di antimoniuro di indio per Chemical Vapour Deposition o sputtering.

Un dispositivo realizzato tramite il procedimento descritto può essere impiegato come sensore di campo magnetico o switch magnetico, come sensore di radiazione elettromagnetica, come emettitore di radiazione elettromagnetica, come cella fotovoltaica, e come cella termofotovoltaica.

* * * * * * *

30,33 Euro

RIVENDICAZIONI

- di di fabbricazione Procedimento un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, detto di operazioni procedimento comprendendo le fabbricare un elemento magnetoresistivo (10; 20) comprendente regioni a conduzione metallica (13; 23) regioni a conduzione semiconduttiva (11; 31) caratterizzato dal fatto che detto procedimento comprende le seguenti operazioni:
 - -formare delle nanoparticelle metalliche (37)
 per realizzare dette regioni a conduzione metallica
 (13; 23);
 - -provvedere un sottostrato di semiconduttore (31);
 - -applicare dette nanoparticelle metalliche (37) a detto sottostrato di semiconduttore (31) per ottenere una struttura mesoscopica disordinata.
- 2. Procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto di sottoporre detto sottostrato di semiconduttore (31) a un processo di attacco chimico al fine di formare dei pori (22) in detto sottostrato di semiconduttore (31).
- 3. Procedimento secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto di applicare dette nanoparticelle metalliche (37) a detto sottostrato



di semiconduttore, introducendo dette nanoparticelle (37) in una soluzione (40) e applicando detta soluzione (40) a detto sottostrato (31).

- 4. Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che è impiegato iun procedimento di condensazione capillare di detta soluzione (40) nei pori (22) di detto sottostrato di semiconduttore (31) al fine di ottenere dette regioni metalliche (23).
- 5. Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che è impiegato iun procedimento di deposizione elettrochimica nei pori (22) di detto sottostrato di semiconduttore (31) al fine di ottenere dette regioni metalliche (23).
- 6. Procedimento secondo almeno una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che per eseguire detto processo di attacco chimico del sottostrato di semiconduttore (31) a detto sottostrato (31) è applicato un template poroso (38), in particolare un template di allumina porosa.
- 7. Procedimento secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che detto attacco chimico fa uso di una soluzione elettrolitica (32) atta ad attaccare detto sottostrato di semiconduttore (31) e che detta soluzione elettrochimica (32) è sostituita

progressivamente dalla soluzione (40) contenente nanoparticelle metalliche (37) lasciando sempre la superficie del sottostrato di semiconduttore (31) immersa, al fine di evitare la penetrazione di aria o gas ambiente in detti pori (22).

- 8. Procedimento secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che comprende inoltre un passo di annealing termico di detto elemento magnetoresistivo (20) al fine di creare dei nanorod in detti pori (22).
- Procedimento secondo la rivendicazione 1, 9. detto passo di fatto che caratterizzato dal provvedere un sottostrato di semiconduttore prevede (31) tramite detto sottostrato crescere di processo di crescita e il passo di applicare dette prevede metalliche (37) nanoparticelle coevaporare dette particelle (37) durante detto processo di crescita di detto sottostrato (31).
- 10. Procedimento secondo la rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto che detto processo di crescita è un processo di sputtering
- 11. Procedimento secondo la rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto che detto processo di crescita è un processo di Chemical Vapour Deposition.

- 12. Procedimento secondo almeno una delle rivendicazioni da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto sottostrato di materiale semiconduttore (31) è realizzato tramite un semiconduttore scelto fra silicio, germanio, antimoniuro di indio, tellururo di mercurio, arseniuro di indio, titanato di carbonio, arseniuro di gallio, carburo di silicio, fosfuro di gallio, nitruro di gallio e allumina.
- 13. Procedimento secondo almeno una delle rivendicazioni da 1 a 12, caratterizzato dal fatto che dette nanoparticelle metalliche (37) sono di un materiale metallico scelto fra oro, argento, alluminio, gallio, indio, rame, cromo, stagno, nichel, ferro, platino, palladio, cobalto, tungsteno, molibdeno, tantalio, titanio, permalloy.
- 14. Procedimento secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di deporre detto sottostrato di semiconduttore (31) su un altro sottostrato isolante.
- 15. Procedimento secondo almeno una delle rivendicazioni da 2 a 14, caratterizzato dal fatto che detta processo di attacco chimico al fine di formare dei pori (22) nel sottostrato di semiconduttore (31) forma dei pori (22) passanti.

- magnetici, del tipo che comprende un elemento magnetoresistivo (10; 20) atto a variare la propria resistenza in corrispondenza dell'applicazione di un campo magnetico (H), caratterizzato dal fatto che detto elemento magnetoresistivo (20) è fabbricato secondo il procedimento secondo le rivendicazioni da 1 a 14.
- 17. Dispositivo secondo la rivendicazione 16 caratterizzato dal fatto che detti elettrodi (14) sono applicati alle superfici laterali di detto elemento magnetoresistivo (20) per applicare una corrente (I).

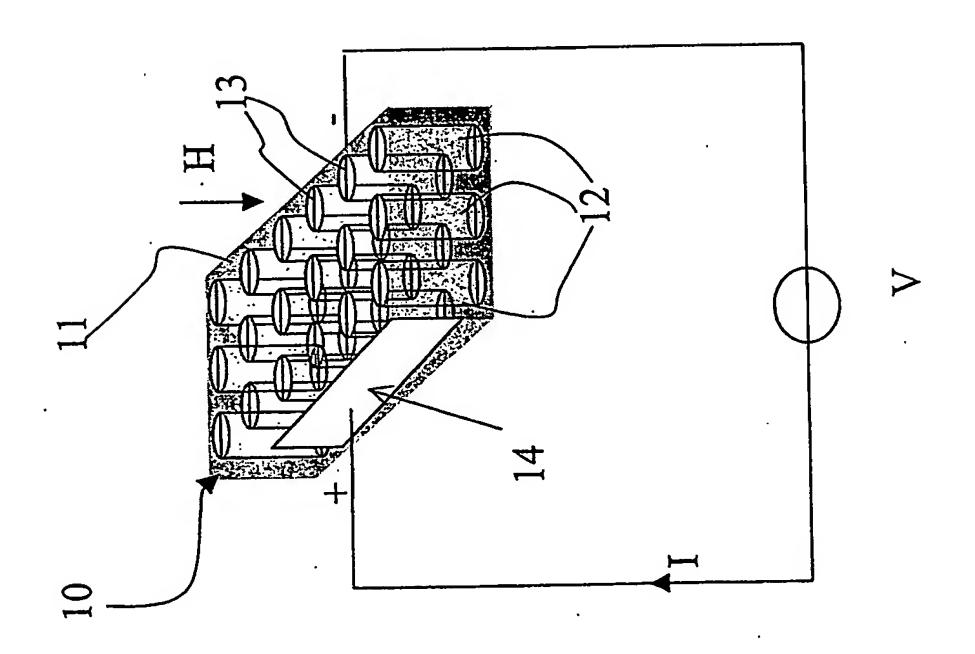
Il tutto sostanzialmente come descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.

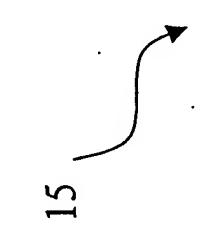
ng. Glancarlo IVOTARO N. Iscylz. AVED 258 Ila proprio e per gli altrii



TO 2003 A 000605

Fig.1

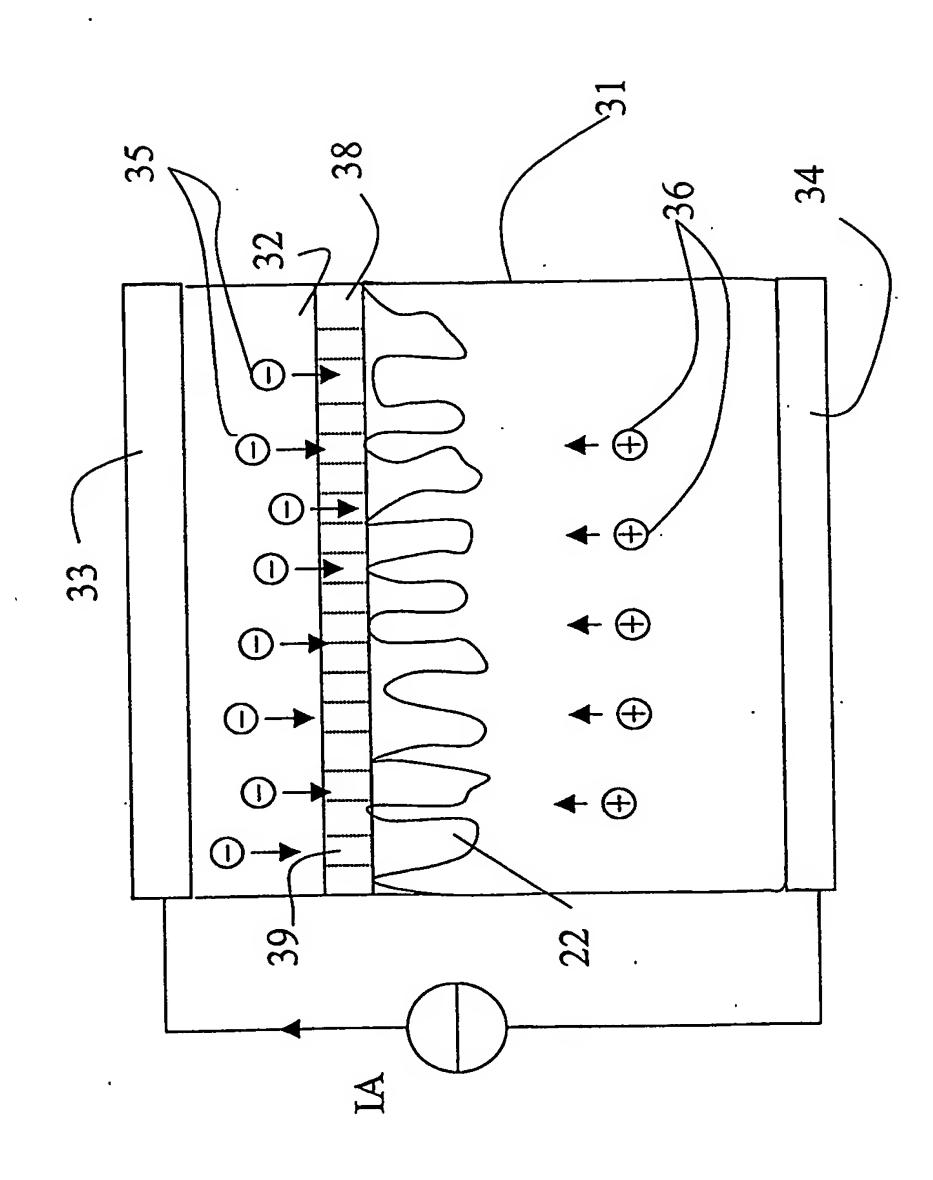




CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Ing. Glancorlo MOTARG N. letr/2/0280 258 I in proppio e per gli altri

Fig. 2A





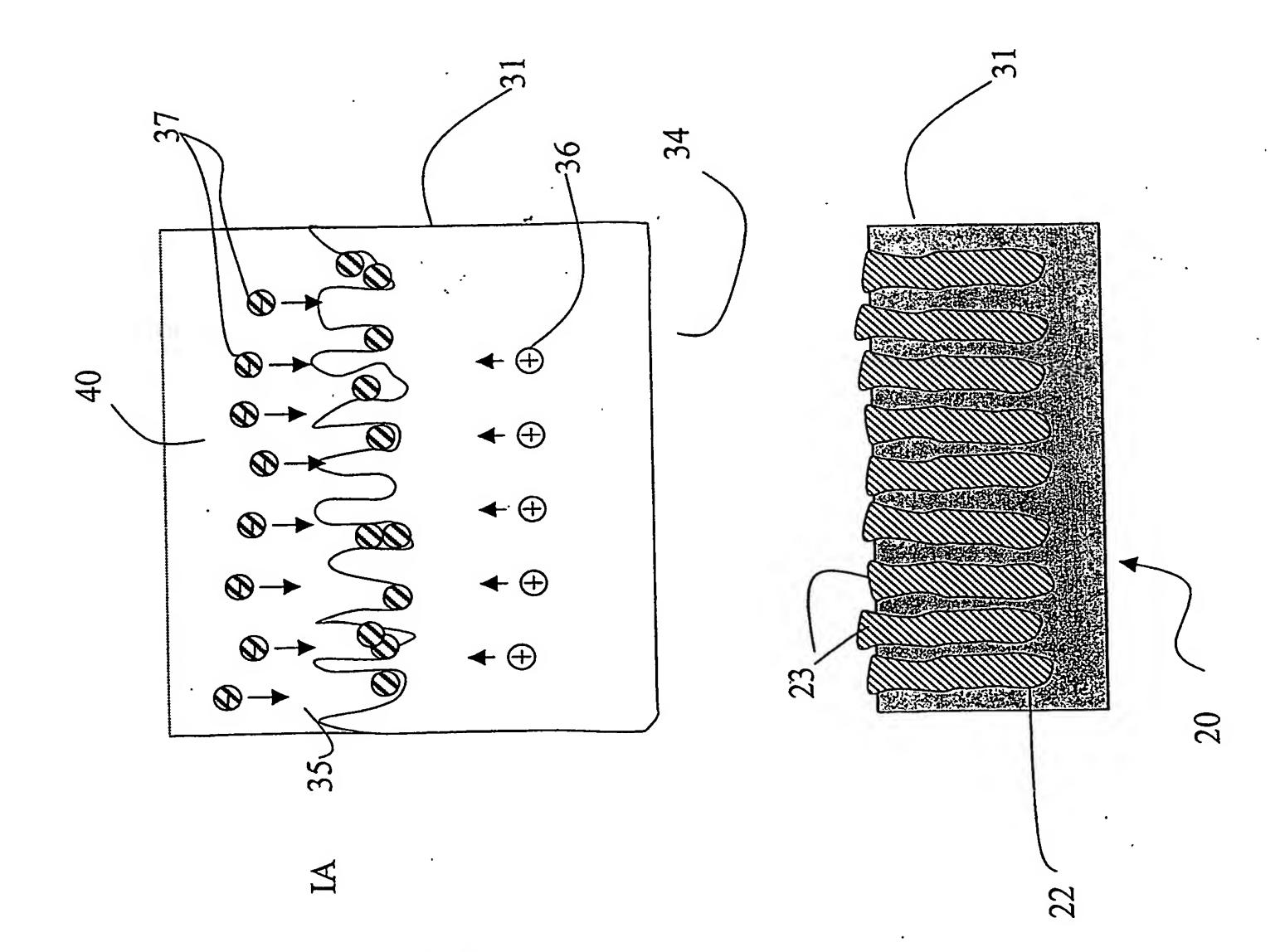
Ing. Giancarlo INOTARO

N. istriz (\$4,50 258

I in preprio e per gli elid)

Fig. 2B

Fig. 2C



CAMERA DI GOMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Ing. Glandario NOTARO N. Ischie, ALBO 258 In peptipe per gli alini

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.